

中美科企受惠两国科技竞赛

早前美国前国务卿基辛格接受西班牙《世界报》访问时表示，中美如爆发「新冷战」将对全球影响较第一次更危险，因当时苏联拥有的经济资源不能与今天与世界经济密不可分的中国比较。可是，中美脱钩相信已成为当今美国两党共识，观察美国总统拜登就任至今举措，着意在各大领域对华施压（例如科技及金融），迫使中国孤立于全球。中国态度上亦转向敢于迎战，全球面对逆风可能性愈来愈高。

根据《2022 年世界知识产权报告》中指出，2021 年专利申请增幅最大是亚洲，首 3 位是中国、韩国及印度。而中国有效专利数量达 360 万件成为世界第一，第二名是美国（330 万件）。话虽如此，美国近年多次在公开场合及不同国际组织指控中国盗取美国科技，当中对华「芯片围堵」最受关注。例如中国使用有关人工智能算法的芯片有 95% 以上是由美国半导体公司设计，并在关键领域上美国拥有不可替代地位。美国商务部在去年 10 月修订人工智能和半导体技术对华出口政策，禁止向中国出口并阻止中国自行制造或从其他地方购买，包括禁止中国获得美国芯片设计软件、制造设备及组件。

有见及此，中国选择了自主研发及生产之路。《数字中国建设整体布局规划》中指出，通过基建及资源体系两大基础，目标到 2035 年时数字化发展水平进入世界前列。同时成立官方机构及厘清职能以准备各项挑战，例如成立国家数据局及中央科学技术委员会，负责监督及加强行业监管，更好地统筹攻坚克难，加快实现高技术水平科技自立及自强。以上操作扎实对上中下游控制，并向大型国企及民企行业龙头，掌握它们在数字价值链中关键环节的操作。理顺监管后，市场普遍认为扭转了近年网络政策及行业监管方针，预期更多「绿灯」及为国际竞争提供更多支持。

中美在科技竞赛中前仆后继，并料在财政及货币政策上大力支持，将有利中美科技企业未来盈利表现，但注意避险投资于两国交迭的企业。投资策略上以「硬件为先」，受惠行业包括半导体（芯片设计及集成设备等）、新能源设备（锂电池及设备）及电讯（光缆、基站天线及主要设备等）。

共勉之。

以上信息由东亚银行首席投资策略师李振豪先生提供

重要声明

本文件由东亚银行有限公司（「东亚银行」）编制，仅供客户参考之用。其内容是根据大众可取得并有理由相信为可靠资料制作而成，惟该等数据源未经独立核证。

此文件中的一切资料只供一般参考用途，有关资料所表达的预测及意见并不构成任何投资的要约或有关要约的招揽、建议、投资意见或保证回报。本文件所表达的信息、预测及意见以截至发布之日期为依据，可予修改而毋须另行通知。有关数据未经香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局或任何香港监管机构审核。

以上文章只反映作者的观点，并不代表东亚银行立场，东亚银行对本文件内有关资料的准确性及完整性或任何所述的回报并不作出任何代表或保证、陈述或暗示及对有关资料所引致的任何问题及/或损失（不论属侵权或合约或其他方面）概不负责。投资涉及风险，投资产品价格可升亦可跌，甚至变成毫无价值。投资产品之过往业绩并不代表将来表现。阁下在作出任何投资决定前，应仔细阅读及了解有关投资产品之销售文件及风险披露声明，并应谨慎考虑阁下的财务情况，投资经验及目标。

投资决定是由阁下自行作出的，但阁下不应投资任何产品，除非中介人于销售该产品时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后，该产品是适合阁下的。

本文件是东亚银行的财产，受适用的相关知识产权法保护。未经东亚银行事先书面同意，本文件内的数据之任何部分不允许以任何方式（包括电子、印刷或者现在已知或以后开发的其他媒介）进行复制、传输、出售、散布、出版、广播、传阅、修改、传播或商业开发。